



附件 3

北京大学纳光电子前沿科学中心加工测试任务单

台账编号:

预约单号		预约起止时间	
预约设备名称		导师及电话	
所在院系		预约人及电话	
校外委托	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	样品数量	
样品描述	例：微环谐振腔加工，衬底： nm SiNx/3um-SiO2/Si; 4inch 光刻胶 maN 掩膜刻蚀；刻蚀深度、侧壁倾斜角及粗糙度要求		
加工工艺 或 测试要求	<ol style="list-style-type: none"> 1. RCA 清洗，烘干； 2. 光镜检查，如有标记请注明。 3. LPCVD 生长 SiNx, XXnm,参数: (片上不许有任何金属) 4. 光镜检查、椭偏仪测量 (自带拟合模型需注明) 5. 图形化, EBL: 工艺参数, 版图: XXX CD; 6. 光镜检查、SEM 测量 7. RIE 打底膜、ICP 刻蚀 SiN, 光刻胶厚度: XXXnm (务必注明: 关键线宽 CD 侧壁形貌要求) 8. 光镜检查、SEM 测量 9. 残胶 Removal 10. 光镜检查 <p>申请人: XXX 接单人: XXX 日期: XXXX</p>		

